

平成13年1月18日

各位

東京応化工業株式会社
(コード番号4186 東証第1部)

東京応化工業グループ中期計画
～ **tok**チャレンジ21～
(平成12年度～平成14年度)

本格的な連結経営の時代を迎えた今日、時代の潮流を見据えながら、21世紀に一段の飛躍を図る為、今般東京応化グループの経営戦略として「中期計画」を策定致しましたので、その概略をお知らせ致します。

1. 将来のビジョン

当社創業以来の経営理念である「技術のたゆまざる研鑽」「製品の高度化」「社会への貢献」「自由闊達」を念頭に置いて、世界市場のファインケミカル分野で、リーディング・カンパニーと成るべく積極的に取組んで参ります。

そして本中期計画の実行を通して、グローバルな競争に勝抜き、事業規模の拡大と収益の向上を両立させつつ、下記に述べる企業像を目指して参ります。

- ・ファインケミカルの分野で、技術開発力に優れ世界市場で高いシェアの製品を数多く有する、世界的に定評のある会社。
- ・収益力が高く財務内容の健全な会社。
- ・株主、顧客、社員や地域社会等当社を取巻くステークホルダーから、高い信頼と満足を寄せられる会社。
- ・環境保全意識の高い会社。

2. 計画の基本

具体的に下記事項を骨子に推進していく事により、業績向上、経営体質の強化を図っていきたいと考えております。

本件に関するお問い合わせは

東京応化工業株式会社 総務部企画広報課

〒211-0012 川崎市中原区中丸子150番地 TEL.044-435-3000(代) FAX.044-435-3020
<http://www.tok.co.jp/>

- ・ 微細加工技術の多角的展開
 ファインケミカル分野で微細加工技術を徹底的に追求してきたのが、当社開発の歴史であることを再認識し、現在世界シェアトップである半導体用フォトレジストの更なる強化を図ると共に、LCD, PDP, PCB分野への多角的展開を図り、更にこれからの分野の関連材料であるCSP材料, SOG材料でシェアトップを目指す。
- ・ M & E の推進 (Materials & Equipment)
 材料と装置の両方を取扱っている強みを生かし、「当社フォトレジストを中心とする材料」と材料の特性を熟知して開発した「当社装置」をトータルシステムとして市場に提供する。
- ・ 子会社との連繫強化
 本格的な連結経営の時代となった今日、生産面, 営業面, 管理面等で国内外の子会社との連携を一層密にし、TOKグループとしての業容拡大及び効率向上を図る。
- ・ 海外戦略の強化
 グローバリゼーションが急加速しているなか、競争で勝ち残り海外市場で確固たる地位確立の為に事業体制の強化を行い、販売の伸長を図る。
- ・ 経営体質の強化
 企業経営のグローバル化が進展する中において、21世紀における当社経営体質の一層の強化を図る。

3. 数値目標

(1) 収支目標 (連結)

単位：億円

	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期
売上高	827	950	1,040
営業利益	95	130	140
経常利益	102	133	145
当期利益	29	79	87

(2) セグメント別売上高・利益目標(連結)

単位：億円

	13年3月目標		14年3月目標		15年3月目標	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
材料事業	697	128	806	160	900	168
装置事業	130	6	144	10	140	12
消去・全社	-	-39	-	-40	-	-40
合計	827	95	950	130	1,040	140

(3) 経営指標等の目標(連結)

	13年3月目標	14年3月目標	15年3月目標
総資産(億円)	1,389	1,473	1,563
株主資本(億円)	1,133	1,201	1,277
経常利益率(%)	12.3	14.0	14.0
ROA(%)	7.6	9.3	9.6
ROE(%)	2.7	6.7	7.1

4. 活動計画

(1) 全社的戦術

「グローバル化推進戦術」

- ・販売体制の強化，サービス体制の充実，生産体制の強化。
- ・情報のスピードアップ化。

「SE(サービスエンジニア)戦術」

- ・顧客ニーズの的確な把握と開発製品のタイムリーな上市による積極的販売展開。
- ・顧客との信頼関係の構築。

「新規戦術」

- ・新製品開発と市場への提供。
- ・長年に亘り培ってきた技術力とノウハウを生かした新規製品と用途開発による既存製品の拡販。
- ・アジア地域の市場開拓。現地事務所の新規設置検討と代理店の掘起し。

「ランクアップ戦術」

- ・品質の均一性と安定的性能の維持。
- ・既存ユーザーに対する技術のフォロー。
- ・既存代理店，ディーラーとの連携強化と密接な情報交換。

「コスト競争力強化戦術」

- ・高性能，低コストの標準品開発とその積極的販売展開による製品品種の統合と原料コスト低減。
- ・流通コスト低減。
- ・事業環境の変化に対応した柔軟な生産体制の構築。

「設備投資」

- ・生産能力増強と合理化投資の実施。
(KrF 量産工場の増設，ArF 生産工場の新設，フレキシ印刷用感光性樹脂版製造設備の増設)
- ・研究開発用機器の充実。
- ・開発合成設備の強化。
- ・効率的 I T 関連投資の実施。

(2) 事業別売上目標及び活動計画

電子材料事業

単位：億円

	平成 1 3 年 3 月期	平成 1 4 年 3 月期	平成 1 5 年 3 月期
売上高	4 7 3	5 5 3	6 1 7

- ・新規レジンによる 0.15 μ m 対応 KrF レジストの拡販。
- ・0.13 μ m 対応 KrF，ArF レジストの世界市場への拡販。
- ・アジア地域(主として台湾,韓国)での積極的営業展開とサービスエンジニアの充実。
- ・液晶ドライバー I C のニーズを的確に把握し、対応レジストの拡販，強化。
- ・生産能力の増強。(工場の増設，新設，新ラインの建設)
- ・平坦化材新製品の積極的市場展開。
- ・銅パーダマシン用 L o w - k 材の開発上市。
- ・銅配線向け剥離液の拡販と新規高性能剥離液の開発上市。
- ・海外生産拠点を最大限に活用し、世界市場での拡大。

ディスプレイ材料事業

単位：億円

	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期
売上高	101	125	142

- ・国内外での積極的営業展開。(SEの充実と工場の増設)
- ・反射型、低温ポリシリコン化への対応。
- ・付属薬品(シナー、剥離液、現像液)の拡販とリサイクル事業の構築。
- ・PDP材料の強化。(フォト誘電体、フォト蛍光体、サンドブラスト用材料)
- ・非クロム系エッチングレジストの開発上市。

画像材料事業

単位：億円

	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期
売上高	123	128	141

- ・ビルドアップ基板用高追従、高解像タイプDFRの開発改良。
- ・LDI(Laser Direct Image)用DFR開発。
- ・ハロゲンフリー、パッケージ等の特殊需要向け製品の開発、拡販。
- ・韓国、台湾市場におけるパッケージ材料の拡販。
- ・WfレベルCSPを視野にいれたCSP関連ニーズの把握。
- ・フレキソ印刷用感光性樹脂版の生産能力増強と世界市場へ向けた積極的営業展開。

装置事業

単位：億円

	平成13年3月期	平成14年3月期	平成15年3月期
売上高	130	144	140

- ・装置と材料との組合せによる他社製品との差別化。
- ・本格的Low-k市場形成に備え、需要増加に対応可能な新規プロセス技術の構築。
- ・ICPプラズマソース(ダメージフリー)の開発上市。
- ・大型TFT(1m角以上)用塗布装置の開発。

5 . 経営施策

(1) 経営管理体制の充実・強化

- ・ 法務対応体制の強化。
- ・ 危機管理体制の強化。
- ・ 利益責任体制の明確化。
- ・ 環境管理体制の強化。

(2) 株主還元 , 株式価値向上に向けての取組強化

- ・ 自社株消却の検討。
- ・ R O E の継続的向上。
- ・ 業績を意識した配当。

(3) I T 利用による効率化の推進

(4) 報酬制度改革

- ・ 賃金制度改革。
- ・ ストックオプション制度の導入検討。

(5) I R 活動の強化

以上